

分割案說明書未完全援用原申請案說明書之範例

原則：

分割後之申請案，其說明書內容如未完全援用原申請案之說明書內容，而係另改寫者，即與原申請案說明書內容不同，為利於判斷分割後之申請案是否超出原申請案申請時說明書所揭露之範圍，申請分割時，須檢附與原說明書差異部分之劃線(或刪除)頁，並就該差異部分為相關說明。

例 1.說明書【0006】新增(劃底線)

本發明一態樣之開關裝置，具有：操作部，供手動操作；偵測部，通過該操作部以偵測可見光、紅外線光及電波中之任一種電磁波；以及機體，容納該偵測部。該操作部具有對於該電磁波之透射率不同的複數個部位。

說明：

依據原申請案申請時說明書【0099】「第 2 態樣之開關裝置 (1)，係藉由與第 1 態樣加以組合而得以實現。於第 2 態樣之開關裝置 (1)，較佳係具備一個以上的偵測部，以偵測可見光、紅外線 光及電波中之任一種電磁波。」及說明書【0123】「第 14 態樣之開關裝置 (1)，係藉由與第 1～第 13 態樣中之任何一種加以組合而得以實現。於第 14 態樣之開關裝置 (1)，較佳係具備一個以上的偵測部，以偵測可見光、紅外線光及電波中之任一種電磁波。較佳係使操作部主體，具有對於電磁波之透射率不同的複數個部位 (第 1 前壁 301、第 2 前壁 302、手柄罩蓋 31)。」等記載，本分割案開關裝置發明態樣之一，可直接無歧異得知具有由該操作部、偵測部及機體等構件及其功能所構成者，並未超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

例 2.說明書【0101】刪除(劃刪除線)

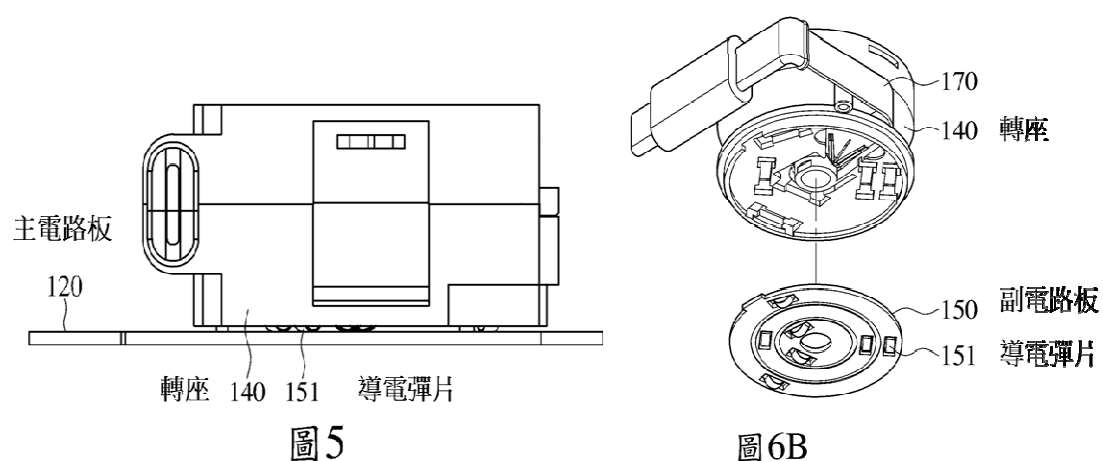
~~第 3 態樣之開關裝置(1)，係藉由與第 2 態樣加以組合而得以實現。於第 3 態樣之開關裝置(1)，較佳係使偵測部藉由偵測人體所放射之紅外線，而對偵測區域內是否有人存在，進行偵測。控制電路，較佳係在偵測部偵測到有人存在時，就判定物理量符合既定之條件，而進行控制動作。~~

說明：

所刪除之內容業於原申請案之請求項 3 請求且經核准，分割案說明書予以刪除後，未超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

例 3.說明書【0017】新增(劃底線)

【0017】 導電彈片 151 的兩端抵靠於副電路板 150 的一側表面，而導電彈片 151 兩端之間的部分可以透過孔位呈圓弧形地突出於副電路板 150 之另一側表面，使得導電彈片 151 可碰觸於主電路板 120 的導電環 121。舉例來說，當主電路板 120 與副電路板 150 的間距為 L 時，則導電彈片 151 從副電路板 150 所突出的高度為 h 。導電彈片 151 的高度 h 至少等於或大於間距 L (圖中未標示 L, h)，如圖 5、6B 所示。



說明：

本分割案「繞線型充電器」之轉座 140 包含一副電路板 150，副電路板 150 包含多個導電彈片 151 與孔位(無標號)，每一個孔位的位置分別對應於導電彈片 151 的位置，再依據原申請案之圖 5 及圖 6B 之示意，進一步就該導電彈片 151 設置於副電路板 150 之型態進一步說明，故能為申請時圖示所支持，並未超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

例 4.說明書【0037】新增(即表一)

【0032】

實施例 1

將 $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{Br}$ (MABr) 11.9mg、 PbBr 239mg、 $\text{HC}(\text{NH}_2)_2\text{I}$ (FAI) 98.59mg、 PbI_2 277.6mg、 CsI 9.74mg 加入溶劑(DMSO、GBL 及 IPA 體積比為 800：200：20)中，形成鈣鈦礦溶液 520 μl 。

【0033】

實施例 2

以實施例 1 的步驟配置鈣鈦礦前驅溶液，但溶劑組成調整為 DMSO、GBL 及 IPA 體積比為 800：200：40。

【0034】

實施例 3

以實施例 1 的步驟配置鈣鈦礦前驅溶液，但溶劑組成調整為 DMSO、GBL 及 IPA 體積比為 800：200：80。

【0035】

實施例 4

以實施例 1 的步驟配置鈣鈦礦前驅溶液，但溶劑組成調整為 DMSO、GBL 及 IPA 體積比為 800：200：120。

【0036】

比較例 1

以實施例 1 的步驟配置鈣鈦礦前驅溶液，但是不添加氯苯。

【0037】

表一

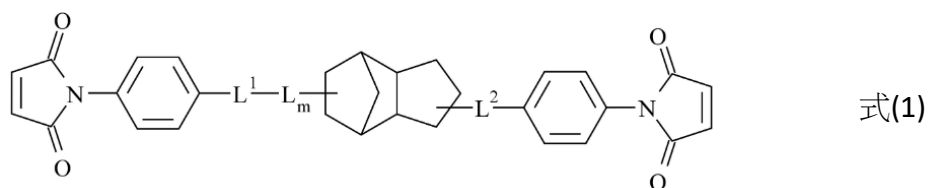
實施例/比較例	前驅液溶劑組成
比較例 1	DMSO : GBL : IPA=800 : 200 : 0
實施例 1	DMSO : GBL : IPA=800 : 200 : 20
實施例 2	DMSO : GBL : IPA=800 : 200 : 40
實施例 3	DMSO : GBL : IPA=800 : 200 : 80
實施例 4	DMSO : GBL : IPA=800 : 200 : 120

說明：

依原說明書第【0032】~【0036】段揭示之溶劑組成及比例，新增表一，以利比較，並未超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

例 5.說明書【0006】新增(劃底線)

本發明的樹脂組合物包括經改質的馬來醯亞胺樹脂，其具有如下述式(1)表示的結構：



L 表示伸二環戊二烯基、衍生自酚類化合物的二價有機基團或其組合， L^1 及 L^2 各自表示衍生自酚類化合物的二價有機基團，且 m 表示 0 至 18 的整數。

說明：

由式(1)可知，原說明書「馬來醯胺」為「馬來醯亞胺」明顯誤記，於分割案說明書一併修正，新增後之內容並未超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

例 6. 說明書段落【00015~0018】刪除(劃刪除線)，新增不同的內容(底部劃線)

即使伴隨彈性材的彈接而產生微粒子的場合，為使其微粒子不隨著蓋部及門部的開放而進入晶圓收納容器內，以構成具備透過設置在上述晶圓收納容器的氣體供應閥將氣體供應於晶圓收納容器內，~~...~~以構成在上述晶圓搬運室的內部形成從上方向下方的氣流為佳。上述夾持單元分別設置在上述開口的左右為佳，...，將上述卡合片配置在與上述突緣部不干涉的位置為佳。

說明：

所刪除之內容業於原申請案之請求項之請求範圍且經核准，分割案說明書予以刪除後，並依原申請案圖 4、5 以及說明書段落 0049~0056 之內容作新增，未超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

例 7. 分割案說明書之構件名稱與原申請案不同

說明：

分割案之說明書及【符號說明】中，就原申請案第 1 圖之「主處理器」、「記憶體裝置」、「儲存裝置」等構件名稱，對應修改為「處理器」、「記憶體」、「儲存器」等構件名稱；該等構件名稱雖有不同，惟該等差異係因前後翻譯使用不同的用語所致，以利與它構件作區隔，實質與原申請案所對應之構件名稱相同。